산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	대한민국 대전환 한국판뉴딜

2021년 11월 22일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 11.22(월) 오전 10시30분 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 11. 19(금)	담당부서	반도체디스플레이과
담당과장	박찬기 과장(044-203-4270)	담 당 자	김대영 사무관(044-203-4272)

「제14회 반도체의 날」 및 「반도체협회 30주년」 기념식 개최

- 문승욱 장관, 글로벌 공급망 재편 움직임에 대응한 민관 협력 강조 -

- 역대 최대 52명 포상, 최고 영예 훈격도 금탑으로 상향 -

□ **산업통상자원부**(장관 문승욱, 이하 '산업부')는 **'21.11.22일(월) 10시 30분 서울 코엑스**에서 문승욱 산업부 장관, 이정배 한국반도체산업협회장(삼성전자 사장), 이석희 SK하이닉스 사장 등 **반도체 분야 산·학·연 관계자 300여명이 참석**한 가운데 **「제14회 반도체의 날」 및 「한국반도체산업협회 창립 30주년」 기념식을 개최**하였다.

○ 「반도체의 날」은 우리나라 **반도체 수출이 최초로 연 100억 달러**를 돌파한 1994년 10월을 기념하여 제정된 이후, 2008년부터 매년 10월에 기념식을 개최해 왔으나, **올해는 코로나19 상황을 감안**해 **11월로 연기하여 개최**하게 되었다.

○ **13회를 맞은 올해 행사**는 **반도체 산업발전에 기여한 산·학·연 유공자에 대한 포상**을 통해 그간의 노고를 격려하는 자리로 특히, 올해는 **한국반도체산업협회 창립('91.11.11일) 30주년**을 맞아 **반도체 업계가 새로운 혁신과 도전을 다짐**하는 자리로 의미가 있다.

< 행 사 개 요 >

■ **(일시/장소)** 2021. 11. 22(월) 10:30~11:50 / 서울 코엑스 401호

■ **(참 석 자)** 문승욱 산업부 장관, 이정배 한국반도체산업협회장(삼성전자 사장), 이석희 SK하이닉스 사장 등 산업계 CEO, 반도체산업발전 유공자 등 약 300여명

■ **(주요내용)** 반도체 산업발전 유공자 포상(52점) 등

□ **문승욱 장관은 축사**를 통해 코로나19에 따른 공급망 불안 등 어려움에도 불구하고 **수출 등 우리경제의 든든한 버팀목 역할**을 담당하고 있는 **우리 반도체 업계의 노고에 감사**의 뜻을 전하며, **글로벌 공급망 재편 움직임에 대응**해 **민·관의 유기적인 협력이 필요함**을 강조하였다.

○ 문 장관은 **소자기업의 대규모 투자가 차질없이 진행**되고 있고, 극자외선(EUV) 장비를 독점하고 있는 **ASML**이 **2,400억원 규모의 재제조 및 트레이닝 센터 설립을 위해 지난주 부지계약을 완료**하는 등 **'K-반도체 벨트 구축'이 빠르게 실현되고 있다**고 언급하면서

- 정부도 지난 5월 발표한 **「K-반도체 전략」을 차질없이 이행**해 **민간 투자를 적극 뒷받침**하여 **세계 최고의 반도체 공급망**을 **구축**하겠다는 포부를 밝혔다.

○ 또한, **반도체 산업의 지속 성장**을 위해서는 **전문인력 양성에 역량을 집중**할 필요가 있다는 점을 강조하면서,

- **민관 공동투자**를 통한 **3,500명 석박사급 인력양성사업 신규 추진, 1,200명 규모의 반도체 전공트랙 내년 신설, 재직자 중심 교육과정 신설** 등의 계획을 밝혔다.

○ 마지막으로 **글로벌 파트너십 구축을 통해 반도체 공급망 안정성을 강화**해 나가야 할 필요성을 강조하면서,

- **12월 「한-미 반도체 파트너십 대화」**를 개최하여 **사람, 기술, 투자**를 중심으로 **양국간 실질적인 반도체 협력사업을 추진**할 계획임을 언급하였다.

□ 반도체의 날을 맞아 우리 반도체 산업 발전에 각고의 노력을 기울인 **반도체 산업 유공자 52명에 대한 정부 포상**도 진행하였다.

* 정부 포상(총 52점) : 산업훈장(금탑1, 은탑1), 산업포장(3), 대통령표창(3), 국무총리표창(4), 산업통상자원부 장관표창(40)

○ 금년에는 정부 포상규모가 **52명**으로 **역대 최대를 기록**하였고, **최고 영예도 작년 은탑에서 금탑으로 훈격이 격상**되는 등으로 지난 5월 발표된 **「K-반도체 전략」에 포함**된 **반도체 산업 발전 유공자에 대한 정부포상 규모 확대 및 훈격 상향이 이행**되었다.

○ **세계 최고 모바일·서버용 D램 개발·양산**에 기여한 **삼성전자 이정배 사장**이 최고 영예인 **금탑산업훈장을 수상**하였고, **국내 최초 메모리 테스트 장비의 국산화** 및 반도체장비 해외 수출의 선봉장 역할로 기여한 **와이아이케이(주) 최명배 대표**가 **은탑산업훈장을 수상**하였다.

- 산업포장은 ㈜원익아이피에스 이현덕 대표, SK하이닉스 이성재 부사장, DB하이텍 이상기 부사장, 대통령 표창은 ㈜케이씨텍 권원택 사장, SK실트론 안정훈 부사장, ㈜이오테크닉스 이태경 부사장, 국무총리 표창은 LX세미콘 고대협 상무, 피에스케이(주) 박상종 전무, ㈜에프에스티 신동영 전무, ㈜버슘머트리얼즈 한양기공 임태준 대표가 수상하였다.

- 이외에도 산업통상자원부 장관표창 40명에 대해서도 시상하였다.

< 반도체 산업발전 정부포상 대상자 >

구 분	훈 격		규모	비 고
정부 포상 (52점)	산업훈장	금탑	1	이정배 사장(삼성전자)
		은탑	1	최명배 대표(와이아이케이)
	산업포장		3	이현덕 대표(원익IPS) / 이성재 부사장(SK하이닉스)/ 이상기 부사장(DB하이텍)
	대통령표창		3	권원택 사장(케이씨텍) / 안정훈 부사장(SK실트론)/ 이태경 부사장(이오테크닉스)
	국무총리표창		4	고대협 상무(LX세미콘) / 박상종 전무(피에스케이) / 신동영 전무(에프에스티) / 임태준 대표(버슘머트리얼즈)
	장관표창		40	구광희 ㈜월비에스엔티 상무 외 39명

□ 반도체 유공자에 대한 포상에 이어 **반도체 장학증서 수여식**, 반도체 협회 창립 30주년을 기념한 **협회 비전선포식, 협회 30년사 봉정식** 등이 진행되었다.

○ 반도체 장학사업은 **반도체 분야 우수인력을 양성**을 목적으로 지난 **2006년부터** 협회 회원사들이 반도체 전공학생을 선발하여 **1인당 1천만원의 장학금을 지원**하는 사업으로 **금번 장학증서 수여식을 통해 17개 회원사가 참여**하여 **총 20명의 학생에게 장학금을 전달**하였다.

○ 또한, 협회의 2030비전과 전략을 발표하는 '**협회 비전 선포식**'과 협회 창립 30주년을 맞아 협회의 역사를 담은 「**한국반도체산업협회 30년사**」**봉정식**도 가졌다.

【붙 임】 1.「제14회 반도체의 날」및 「반도체협회 30주년」 기념식 개요
2.「제14회 반도체의 날」정부 포상자 명단

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 김대영 사무관(☎ 044-203-4272)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1 「제14회 반도체의 날」 및 「협회 창립 30주년」 기념식 개요

1. 개최배경

□ 국가 주력산업인 **반도체 산업의 성과와 위상을 대외에 홍보, 반도체 산·학·연의 노고를 격려**하는 **「반도체의 날」** 기념식 개최

* 반도체 수출 100억불 달성('94.10.29)을 기념하여 제정해 '08.10.29일 1회 행사 개최, 매년 10월 넷째주 목요일에 기념식 행사를 진행하였으나 금년은 코로나19 상황 감안해 11월로 연기

□ **금년은 반도체협회 창립 30주년**('91.11.11일 창립) **기념행사**로 개최

* 30주년 축하영상(초대협회장, 미·중 반도체협회), 「협회 30년사」 봉정식 등 진행

2. 행사개요

□ **일시/장소 : '21.11.22**(월) **10:30~11:50 / 코엑스 4층 401호**(온라인 동시 중계)

□ **참석자 : 산업부 장관, 삼성전자 이정배 사장**(협회장), **SK하이닉스 이석희 사장**, 업계 CEO, 반도체산업 유공자 등 **약 300여명***

* 백신 접종 완료자만 참석 : 11.1일 시행 방역지침상 백신 접종 완료자만으로 최대 499명 행사 가능

□ **주요내용 : 반도체 산업발전 유공자 포상, 협회 30주년** 기념 **비전 선포식** 및 **30년사 봉정식**

3. 세부일정(안)

시간		주요 내용	비고
10:30~10:33	3′	▪ 개회 및 국민의례	사회자
10:33~10:37	4′	▪ 개회사	협회장
10:37~10:41	4′	▪ 축사	산업부 장관
10:41~11:05	24′	▪ 유공자 포상(52점 : 훈·포장·표창 12점, 장관 표창 40점)	산업부 장관
11:05~11:10	5′	▪ 금탑·은탑 산업훈장 수상자 축하 영상	삼성전자/엑시콘
11:10~11::20	10′	▪ 반도체협회장상 포상(30점)	협회장
11:20~11:30	10′	▪ 반도체장학증서 수여식(17개사 20명)	기업 대표
11:30~11:35	5′	▪ 30주년 축하영상(초대협회장, 미·중 반도체협회장)	-
11:35~11:45	10′	▪ 협회 비전 선포식	협회 부회장
11:45~11:50	5′	▪ '협회 30년사' 봉정식	협회장/협회직원

붙임 2 「제14회 반도체의 날」 정부 포상자 명단

□ 정부 포상 : 산업훈장(금탑1, 은탑1), 산업포장(3), 대통령표창(3), 국무총리표창(4), 산업부 장관표창(40) 등 총 52점

포상 훈격	대상자	소속 및 직급	성명	공적 개요
산업훈장 (금탑)		삼성전자㈜ 사장	이정배	▪ 메모리 세계시장 점유율 1위 유지, 저유해성/무해성 물질사용 기술 개발로 환경인증 확보 ▪ 세계 최고속도 최대용량 모바일 D램 개발 및 양산, 서버용 EDP D램 양산으로 슈퍼컴퓨터 기술 선도
산업훈장 (은탑)		와이아이케이㈜ 대표이사	최명배	▪ 메모리 모듈 테스트 장비를 시작으로 웨이퍼 테스터, SSD 테스터 등 국산화 제품 증대 및 기술력 확보 ▪ 기술 협력 Infra를 활용하여 소재·부품·장비 아이템 발굴을 통해 협력 회사와의 동반성장과 고도화 추진
산업포장 (3점)		㈜원익아이피에스 대표이사	이현덕	▪ 독자적 기술의 장비 개발로 최고 성능의 PE-CVD 설비 개발 및 국내 최초 복합막 증착 장비 확보 ▪ 반도체 장비의 핵심 중요 부품의 공동 개발을 통한 국산화 및 산업 생태계 구축에 기여
		에스케이하이닉스㈜ 부사장	이성재	▪ 세계 최초 DDR5, 20나노급 DDR4 기반 16GB NVDIMM 개발 및 고용량 모듈 제품 세계 최초 개발 ▪ DRAM 모듈 PCB제조 협력사와 PCB 공정 기술 공동 개발로 동반 성장 및 사회적 가치 창출
		㈜디비하이텍 부사장	이상기	▪ 복합 고전압 소자 BCD 공정기술의 혁신적인 도전을 통해 팹리스 회사에 세계 최초 파운드리 서비스 제공 ▪ 많은 국내 팹리스 업체를 지원하여 중소 팹리스 업체의 성장과 안정화에 기여
대통령표창 (3점)		㈜케이씨텍 사장	권원택	▪ 국내 유일한 CMP 장비 제작사로써 외산 장비의 성능을 넘기 위한 기술개발이 탑재된 장비 개발 참여 ▪ 국내 반도체 기업과의 기술협력 및 개발방향 제시, D 평가 및 개선 대책 제안 등으로 소재 개발에 성공
		에스케이실트론㈜ 부사장	안정훈	▪ Wafer의 제조 물류/공정 자동화 최초 설계 및 구축, 자동화 설비 및 공정 Layout 설계능력 100% 내재화 ▪ 핵심 공정 자동화 사업에 장비 제조 강소기업 육성, 핵심 원부자재 일본 의존 감소를 위한 업체 육성
		㈜이오테크닉스 부사장	이태경	▪ 반도체 Marking 장비는 60%이상 점유하며 선두기업 유지, 고부가가치의 레이저 소스 개발 완료 ▪ 자체 생산장비에 소요되는 레이저 소스의 50% 수준까지 내재화 성공 및 세계시장의 90%이상 점유
국무총리표창 (4점)		㈜엘엑스세미콘 상무	고대협	▪ 세계 최초 디지털 TV 방송수신 및 비디오 디코더 칩셋 및 세계 최초 HEVC 영상압축표준 칩셋 개발 등 ▪ P-OLED워치용 LTPO 기술 확보에 노력하였으며, 국내 설계전문 중소기업들과의 협력을 통해 동반성장 추진
		피에스케이㈜ 전무	박상종	▪ Plasma Source 및 450mm Dry Strip 장비 등을 개발하여, 해외 업체가 장악하고 있던 장비 국산화 성공 ▪ 반도체 Dry Strip 장비와 부품 국산화에 기여, 해외 업체에 즉각적으로 대응할 수 있는 기술을 확보
		㈜에프에스티 전무	신동영	▪ EPMD 장비개발로 세계 수준 기술력 보유 및 수입에 의존하는 장비 중 국내 유일의 펠리클 기업으로 성장 ▪ 상생협력과 동반성장 기반으로 반도체 생산성 확보 및 공동 발전에 기여하였으며, 경제 발전에 기여
		㈜버슘머트리얼즈 한양기공 대표이사	임태준	▪ 가스 및 케미컬 및 대용량 공급시스템 등을 국내 최초로 개발하는데 기여하였으며 최초로 상용화 성공 ▪ 반도체 라인에 공급되는 가스공급 시스템의 국산화를 통한 수입 대체 및 경쟁력을 확보할 수 있도록 기여

포상훈격	소 속	직급	성명	공적 개요
산업부 장관표창 (20/30)	㈜윌비에스엔티	상무	구광희	■ 반도체 공정에 사용되는 부품의 국산화로 인하여 국내 산업발전에 기여 및 국가 경쟁력 강화에 이바지함
	앰코테크놀로지코리아㈜	수석	구본완	■ 저비용 테스트 솔루션 개발을 통한 국내외 매출액 증대 및 양산 셋업을 통해 수출 증대에 기여함
	㈜케이이씨	부장	권부섭	■ 에너지 비용 절감, 원재료 업체 다원화/자체 생산, 공정 개발/개선을 통한 반도체 산업 발전에 기여함
	주성엔지니어링㈜	수석	김덕호	■ 차세대 핵심 공정을 대응하기 위한 시공간 분할 ALD 장비 개발을 통하여 산업 발전에 이바지함
	에이에스엠엘코리아㈜	상무	김동주	■ EUV 시스템의 고출력 난제극복을 통한 양산성 및 300명의 한국엔지니어 전문가 양성에 기여
	㈜에프에스티	상무	김명전	■ 고품질 펠리클 개발을 직접 주관하였으며, 노광 공정에서 요구하는 품질 수준 달성으로 국산화에 기여함
	㈜디비하이텍	수석	김종민	■ 고전압 BCD 공정용 ESD 소자의 포트폴리오를 확립, 소자 개발 제공을 통한 파운드리 산업 활성화에 기여
	한국전자통신연구원	실장	김혜진	■ 유연 압전 복합소재 등 핵심소재 원천기술을 개발하여 해외의존도가 높은 압전소재 국산화
	㈜라닉스	전무	남승현	■ 자동차 분야의 통신 및 보안 시스템 반도체를 자체 기술로 개발하여 반도체 산업 발전에 기여함
	㈜성도이엔지	상무	명노희	■ 전방 생산업체의 초고순도 특수 시스템 설계 및 시공을 담당하여 반도체 산업 발전에 기여함
	㈜지니틱스	수석	명성삼	■ 터치 IC SW개발 업무를 담당하였으며, 터치 IC 세계시장 점유율 1위를 달성하여 국가 경쟁력 제고
	삼성전자㈜	수석	민재호	■ 초고집적 메모리 반도체 구현을 위한 혁신적인 평면/수직 패터닝 기술 개발로 집적화 기술 한계 극복
	㈜가온칩스	상무	박대남	■ 시스템반도체 분야에서 청년 일자리 창출과 정부정책에 부응할 수 있는 기업으로 성장하는데 기여함
	에스케이하이닉스㈜	PL	박성조	■ 3D NAND 96/128단의 공정 산포 점검을 통한 수율 Ramp-up 및 Server향 NAND 품질 확보에 기여함
	㈜에스티아이	이사	박영수	■ Wafer Fab 장비/공정에 대한 개선 및 양산, 연구개발을 통해 반도체 산업의 경쟁력 향상에 기여함
	삼성전자㈜	그룹장	박호우	■ LSI 제품향 CMOS 이미지 센서 공정 개발을 주도, 소자 특성 고도화를 통해 제품 경쟁력 향상에 기여함
	세메스㈜	수석	오두영	■ Photo 공정 분야의 경쟁력 확보를 통해 국내 반도체산업 발전에 유무형적으로 크게 기여함
	에스케이하이닉스㈜	PL	이규제	■ MR-MUF 특화기술 개발을 통해 HBM제품의 세계 1위로 도약하는데 중추적 역할을 하였음
	피에스케이홀딩스㈜	이사	이동희	■ 반도체 후공정 Fluxless Reflow 설비 및 Chuck Heater와 가공품, 센서 등의 국산화 성공에 기여함
	하이덴하인코리아㈜	대표이사	이명근	■ 엔코더 기술을 국내 반도체의 각종 후공정/전공정 장비 개발에 참여하여 장비 국산화에 크게 기여함

포상훈격	소 속	직급	성명	공적 개요
산업부 장관표창 (10/30)	㈜코미코	이사	이용수	■ 반도체 부품 Recycling 기술의 발전을 통해 선폭미세화에 따라 요구되는 세정/코팅 기술을 향상
	㈜실리콘마이터스	연구위원	이윤기	■ OLED TV PMIC 개발/양산 및 중국 대형 LCD(TV)용 PMIC 시장 신규 진입, 양산에 크게 기여함
	㈜에이디테크놀로지	전무	이은주	■ 시스템반도체 제작 및 시스템 반도체 제조분야 생태계의 주축이 되게 하여 팹리스 산업 발전에 기여함
	솔브레인㈜	상무	임정훈	■ 반도체 소재 개발로 제품군 매출액 1조 달성 및 세계 최초 고선택비 질화막 식각액 개발에 기여함
	한양대학교	교수	전형탁	■ AVS-ALD 학회를 공동으로 창립, 원자층 증착기술의 세계화와 한국의 위상을 높이기 위해 활동
	㈜라온텍	부사장	정민수	■ 메타버스 세상의 핵심인 XR 기기의 핵심 반도체 기술을 개발하여 세계 최고의 반도체 기술 확보
	한양대학교	교수	정진욱	■ 실시간 플라즈마 계측 장비를 세계 최초로 개발 및 국제 특허 획득, 개발 기술로 국산 장비 공정 개선
	한국과학기술원	교수	조성환	■ 반도체설계인력양성을 위해 설립된 반도체설계교육센터에서 운영위원을 역임하여 인력양성에 기여
	제엠제코㈜	대표이사	최윤화	■ 국내 전무한 파워반도체 핵심기술을 이용하여 소부장 기업과의 지속적인 상생협력으로 글로벌 시장 선점
	한국전자기술연구원	센터장	황태호	■ 반도체 분야 원천기술 확보와 K-반도체 전략 등 여러 예타 및 발전전략 기획에 참여하여 산업 경쟁력 확보
산업부 장관표창 (대중소 상생협력) (10/10)	한국산업기술평가관리원	책임	강신헌	■ 반도체 관련 국가연구개발사업의 기획, 평가, 관리업무를 성실히 수행하여 반도체산업의 기술경쟁력 제고
	㈜원익아이피에스	부장	김성균	■ AIN Heater와 Gas Panel의 국산화를 통해 수입을 대체하였으며, 주요 협력사 육성에 기여함
	㈜디비하이텍	수석	김영민	■ 반도체 장치 기술 개선과 비메모리 반도체 소재, 부품, 장치 국산화를 통해 국내 반도체 산업 활성화
	와이아이케이㈜	이사	김유석	■ Memory 검사장비를 개발하여 공급하고 생산 Cost 효율을 증대시키는 각종 Test Application을 개발
	주성엔지니어링㈜	수석	백인우	■ 차세대 반도체 시장을 주도할 원자층 증착 장비인 TSD System을 개발하여 국산화에 성공함
	㈜테스	상무	양재영	■ 300mm 반도체 장비 국산화 및 수입을 대체하였으며 반도체 소자기업의 생산성 향상에 기여
	㈜유진테크	과장	윤창훈	■ 반도체 장비 및 부품개발 분야에서 탁월한 창의성과 성실함을 바탕으로 우수한 성과를 발휘
	삼성전자㈜	수석	이상훈	■ DRAM 및 VNAND 등 최신 메모리 제품 Test 공정 구축에 필요한 Test 기술 개발을 주도
	피에스케이㈜	책임	이종찬	■ Edge clean 장비 개발 과정에서 장비의 성능을 향상하였으며, 반도체 성능 개선 사업으로 추진
	에스케이하이닉스㈜	TL	진승우	■ 국내 반도체산업 동반성장 및 상생협력을 통한 DRAM 최첨단 제품에 국내 개발된 Melt laser 공정 도입